杭州士兰微电子股份有限公司

关于为控股子公司提供日常担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有
限公司、杭州美卡乐光电有限公司（以下分别简称“士兰集成”、“士兰集昕”、
“美卡乐”）。士兰集成、士兰集昕和美卡乐均为本公司之控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年4月1日至2025
年4月30日，公司在年度预计日常担保额度内为士兰集成签署了担保金额为0.70
亿元的最高额担保合同，为士兰集昕签署了担保金额为3.00亿元的最高额担保
合同，为美卡乐签署了担保金额为0.25亿元的最高额担保合同。

截至2025年4月30日，公司为士兰集成实际提供的担保余额为4.39亿元，
公司为士兰集昕实际提供的担保余额为8.39亿元，公司为美卡乐实际提供的担
保余额为0.99亿元；担保余额均在公司相关股东大会批准的担保额度范围内。

- 上述担保无反担保。
- 本公司不存在逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）年度预计日常担保进展情况

2025年4月1日至2025年4月30日，公司在年度预计日常担保额度内实
际签署的担保合同如下：

担保合同名称	担保合同签署日期	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式
本金最高额保证合同	2025年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币0.70亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保
本金最高额保证合同	2025年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有 限公司	中国建设银行股份有限公司 杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币3.00亿元及其利	连带责任保证担保

					息、费用等	
本金最高额保证合同	2025年4月2日	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币0.25亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》，同意公司在2024年度对资产负债率为70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过29亿元。实际发生担保时，公司可以在上述预计的担保总额度内，对资产负债率为70%以下的不同控股子公司相互调剂使用其预计额度；如在年中有新设控股子公司的，公司对新设控股子公司的担保，也可以在上述预计担保总额度范围内调剂使用预计额度。本次担保预计金额包含以前年度延续至2024年度的日常担保余额。本次担保预计额度自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，且在公司2024年年度股东大会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保均为有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临2024-020、临2024-026和临2024-038。

本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股东大会审议。

（三）截至2025年4月30日：

1、公司为士兰集成、士兰集昕、美卡乐提供的担保均为日常担保。公司为士兰集成实际提供的担保余额为4.39亿元，为士兰集昕实际提供的担保余额为8.39亿元，为美卡乐实际提供的担保余额为0.99亿元；担保余额均在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。

2、公司日常担保余额为18.13亿元，剩余可用担保额度为10.87亿元，担保余额在公司2023年年度股东大会批准的年度预计日常担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

（一）截至目前，被担保人的基本情况如下：

公司名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地	法定代表人	注册资本 (万元)	本公司持股比例 (%)		主营业务
						直接	间接	
杭州士兰集成电路有限公司	913301017265863549	2001年1月12日	浙江杭州	陈向东	90,000	99.17		芯片制造
杭州士兰集昕微电子有限公司	91330101MA27W6YC2A	2015年11月4日	浙江杭州	陈向东	224,832.8735	47.73	32.35	芯片制造
杭州美卡乐光电有限公司	91330101689094018G	2009年7月2日	浙江杭州	江忠永	17,000	43.00	56.53	LED封装

(二) 被担保人士兰集成最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位: 人民币 万元

项 目	2025年3月末/2025年1-3月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	173,468	168,248
负债总额	71,235	72,092
净资产	102,233	96,156
营业收入	44,281	154,145
净利润	6,077	14,196

被担保人士兰集昕最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位: 人民币 万元

项 目	2025年3月末/2025年1-3月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	331,972	341,496
负债总额	126,356	135,314
净资产	205,616	206,182
营业收入	35,356	143,015
净利润	-567	-5,447

被担保人美卡乐最近一年及一期的主要财务数据如下:

单位: 人民币 万元

项 目	2025年3月末/2025年1-3月 (未经审计)	2024年末/2024年度 (经审计)
资产总额	38,304	39,795
负债总额	17,882	19,049
净资产	20,422	20,746
营业收入	5,694	31,263
净利润	-324	1,475

(三) 士兰集成、士兰集昕、美卡乐均为本公司之控股子公司，其未被列为失信被执行人，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

担保合同名称	保证人	被担保人	债权人	担保金额	担保方式	担保期限
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集成电路有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币0.70亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州士兰集昕微电子有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币3.00亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	
本金最高额保证合同	杭州士兰微电子股份有限公司	杭州美卡乐光电有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州高新支行	担保的本金余额不超过人民币0.25亿元及其利息、费用等	连带责任保证担保	

上述担保无反担保。上述担保非关联担保。

四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够有效监控其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内；被担保人的其他股东主要系财务投资和产业扶持的专业产业投资基金，持股比例较小，且不参与控股子公司的日常经营，暂无明显提供担保的必要性。因此其他股东未提供同比例担保，不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2024年4月7日召开的第八届董事会第二十次会议和2024年5月17日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年4月9日和2024年5月18日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2024-020、临 2024-026 和临 2024-038。

六、累计对外担保数量

截至目前，公司及控股子公司批准对外担保总额为 45.566 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.30%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 39.85 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 32.62%；公司为厦门士兰集科微电子有
限公司提供的担保总额为 5.716 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 4.68%。
公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保总额包含已批准的担保
额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日